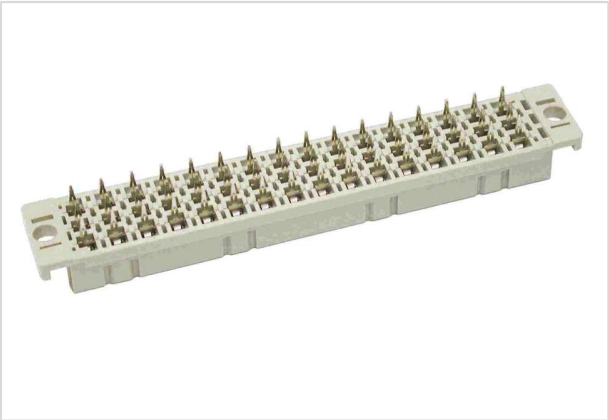


DIN-Power Flow048FP-4,5C1-2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 06 248 6832
规格	DIN-Power Flow048FP-4,5C1-2
浩亭电子目录	https://harting.com/09062486832

标识

类别	连接器
系列	DIN 41612
标识	F型
原件	母连接器
插针端子介绍	直式

版本

接线方式	压接终端
连接方式	主板到子插件板 堆栈
针数	48
插针布局	z、d 和 b 排，位置 2、4.....30、32
连接长度	4.5 mm
编码	孔编码 不缺针的编码方式 带护罩编号
PCB 固定	带固定法兰

技术参数

插针排	3
针间距 (接线端)	3.81 mm 5.08 mm
针间距 (插拔端)	3.81 mm 5.08 mm
额定电流	6 A

技术参数

额定电流	额定电流在 20°C 下测得，请参见降额曲线了解详细信息
放电距离	≥1.6 mm
爬电距离	≥3 mm
绝缘阻抗	>10 ¹² Ω
接触电阻	≤15 mΩ
极限温度	-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
插入力	≤75 N
拔出力	≤75 N
性能等级	2 符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数	≥400
测试电压 U _{r.m.s.}	1.55 kV (接头-接头)
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度	≥1.6 mm
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属 界面端 Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

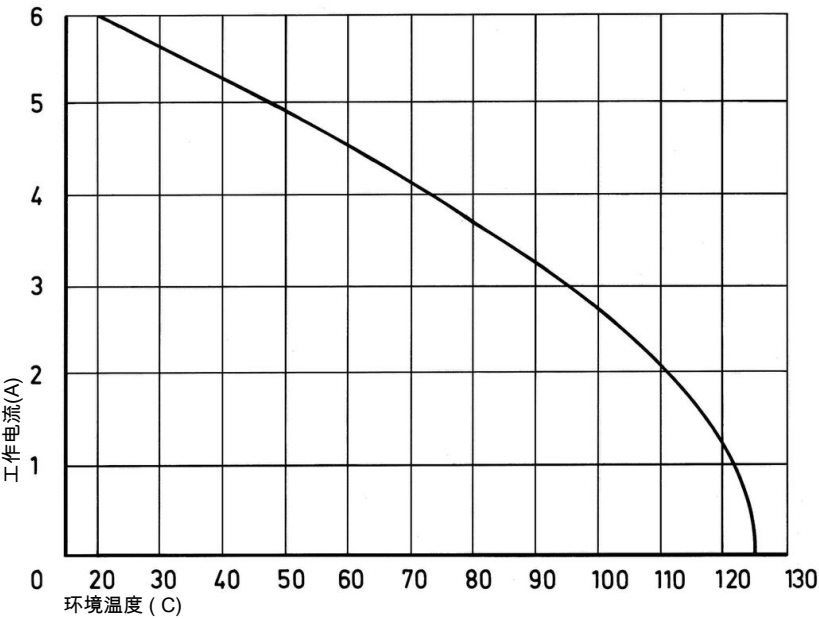
规格	IEC 60603-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类	F4/I3 按照NFF 16-101/102

商业数据

包装尺寸	20
净重	13.34 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140013865
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415

电流承载能力

连接器电流承载能力受接触件材料的热负荷能力限制，包括连接和绝缘零件。因此降额曲线在不超过允许的最高温度下，显示均匀持续地（无间断）通过每个插针的电流。
测量和测试技术符合 IEC 60512-5-2 标准



孔编码 (无针损)



为了避免相邻连接器的误插拔，需要一个编码系统。
根据草图在公连接器的预居中点钻孔。使用安装工具 09 99 000 0103 将编码针 09 06 000 9950 插入母连接器的现有孔中。

带护罩编号 (无针损)



为了避免相邻连接器的误插拔，需要一个编码系统。
按照图纸所示将码键 09 06 001 9919 插入母连接器其中一个键槽中。扳掉公套的相应部位。PCB板和PCB板间距在 20.32 mm 以上时才能使用采用这种编码方法的连接器。

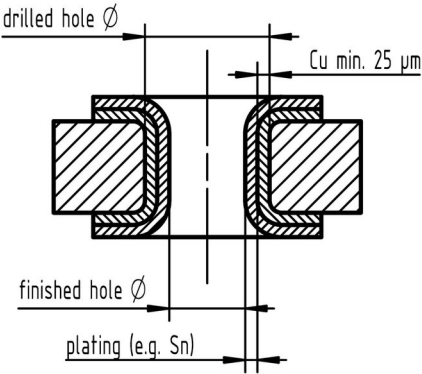
不缺针的编码方式

为了避免相邻连接器的误插拔，需要一个编码系统。
这可通过在母连接器上需要的针位装入一个编号件(带针弹簧)实现。
而与之相对的公针必须用专门的工具将其移除。建议至少使用 3 个编码针。

编码针 09 04 000 9908

用于公针的拆除工具 09 99 000 0038

通镀孔推荐配置



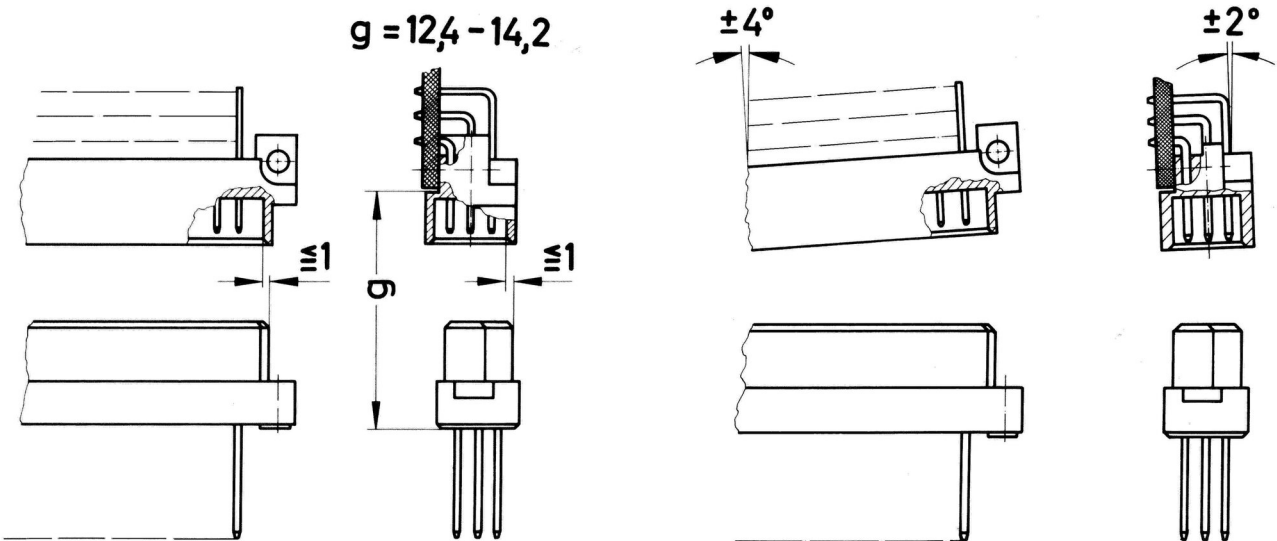
Tin plated PCB (HAL) acc. to EN 60352-5	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Sn	max. 15 µm
	plated hole Ø	0,94 – 1,09 mm
Chemical tin plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Sn	min. 0,8µm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm
Gold /Nickel plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Ni	3 – 7 µm
	Au	0,05 – 0,12 µm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm
Silver plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Ag	0,1 – 0,3 µm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm
Copper plated PCB (OSP)	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm

除热风级 (HAL)，其他 PCB 表面变得越来越重要。由于各自不同的属性，如机械强度和摩擦系数，我们推荐上述 PCB 通孔配置。

组装说明

强烈建议使用浩亭压入工具，以确保可靠的压接过程。有关压接过程的工具、机器和更多信息，请参阅目录。

插接条件



为了保证针可靠闭合并防止损坏连接器，必须注意以下安装说明。
这些插接条件符合 IEC 60603-2。
连接器不允许带电插拔。